华强电子网集团
Huaqiang Electronic Network Group

芯八哥

2023Q1

电子元器件销售行情分析与预判

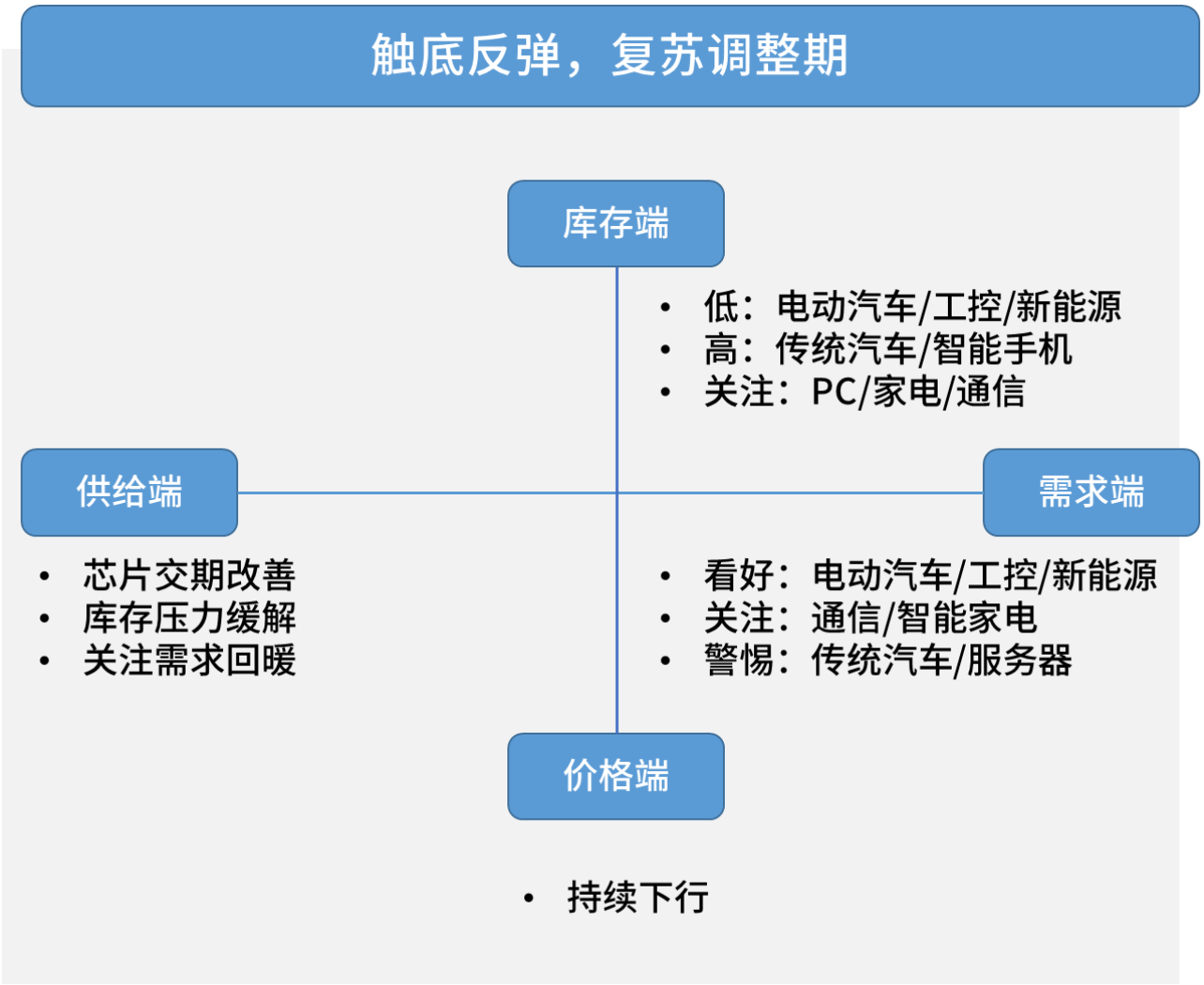
正文目录

序章.....2
一、宏观经济与半导体贸易.....2
1、宏观经济分析.....2
（1）全球制造业持续低位徘徊，稳中趋弱.....2
（2）电子信息制造业下滑明显，持续走低.....3
2、半导体市场分析.....4
（1）半导体销售持续下跌，中国据首.....4
（2）半导体指数回调，市场犹疑.....5
3、芯片交期趋势.....5
（1）芯片交期趋势.....5
（2）供应商交期汇总.....6
4、订单及库存情况.....7
二、半导体供应链.....9
1、半导体上游厂商.....9
（1）硅晶圆/设备.....9
（2）原厂.....10
（3）晶圆代工.....11
（4）封装测试.....12
2、分销商.....12
3、系统集成.....13
4、终端应用.....13
（1）消费电子.....13
（2）汽车.....14
（3）工控.....15
（4）光伏.....15
（5）储能.....16
（6）服务器.....17
（7）通信.....17
三、分销与采购机遇及风险.....17
1、机遇.....17
2、风险.....18
四、小结.....19
免责声明.....20

图表目录

图表 1：Q1 全球主要经济体制造业 PMI.....3
图表 2：2023 年 2 月电子信息制造业运行情况.....3
图表 3：2023 年 2 月全球半导体行业销售额及增速.....4
图表 4：2023 年 2 月全球半导体各区域销售额（亿美元）.....4
图表 5：2023Q1 费城及申万半导体指数走势.....5
图表 6：2023Q1 芯片交期趋势.....5
图表 7：2023Q1 重点芯片供应商芯片交期一览.....6
图表 8：Q1 市场热点品类及厂商一览.....8
图表 9：Q1 头部企业订单及库存情况.....8
图表 10：Q1 半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况.....9
图表 11：Q1 主要原厂最新动态.....10
图表 12：Q1 主要晶圆代工厂最新动态.....11
图表 13：Q1 主要封测厂商动态情况.....12
图表 14：Q1 主要元器件分销商最新动态.....12
图表 15：Q1 主要系统集成商最新动态.....13
图表 16：Q1 消费电子厂商最新动态.....13
图表 17：Q1 汽车厂商最新动态.....14
图表 18：Q1 工控厂商最新动态.....15
图表 19：Q1 光伏厂商最新动态.....16
图表 20：Q1 储能厂商最新动态.....16
图表 21：Q1 服务器厂商最新动态.....17
图表 22：Q1 通信厂商最新动态.....17
图表 23：Q1 细分市场机会关注.....18
图表 24：Q1 细分市场风险预警.....18

序章



一、宏观经济与半导体贸易

1、宏观经济分析

（1）全球制造业持续低位徘徊，稳中趋弱

2023Q1，全球经济复苏态势回调，但除中国外，包括美国、欧盟及日本等主要经济体仍处低位，复苏动能依然不足。

图表 1：Q1 全球主要经济体制造业 PMI

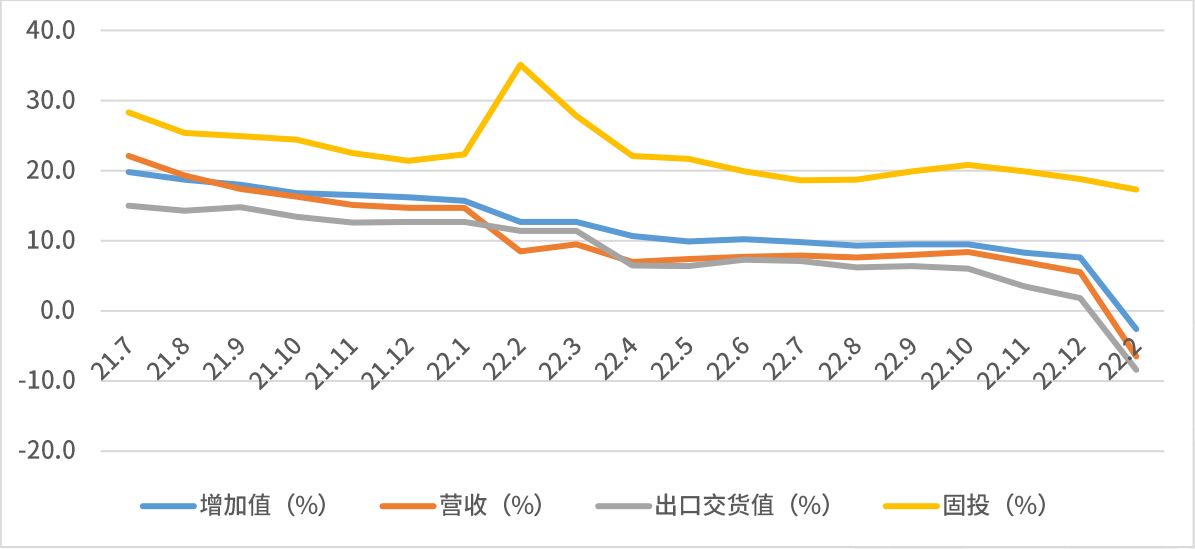
资料来源：国家统计局

综上，疫情不再是影响世界经济复苏主要因素，但供应链稳定性仍不牢固。

（2）电子信息制造业下滑明显，持续走低

1-2 月，电子信息制造业生产规模同比小幅收缩，出口呈下降态势，企业效益下滑明显，投资保持较快增长。

图表 2：2023 年 2 月电子信息制造业运行情况



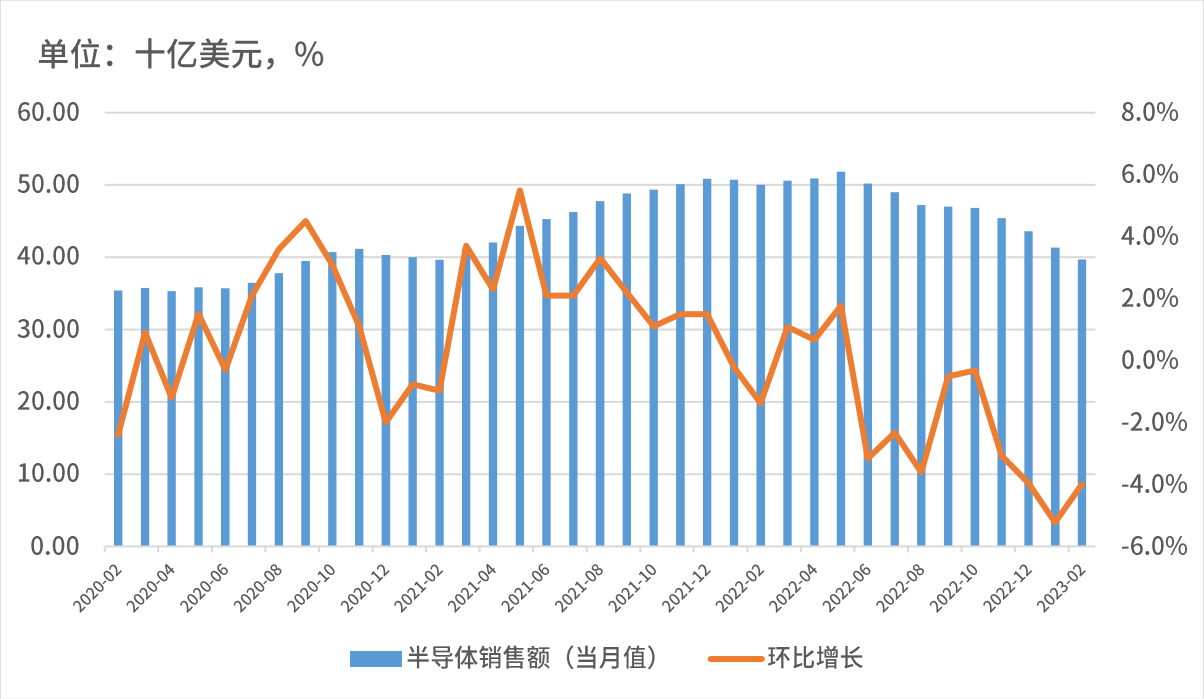
资料来源：工信部、芯八哥整理

2、半导体市场分析

（1）半导体销售持续下跌，中国据首

2 月，全球半导体行业销售额为 397 亿美元，连续 6 个月环比下滑。同比跌幅达 20.7%，创 2009 年以来最大的跌幅。

图表 3：2023 年 2 月全球半导体行业销售额及增速



资料来源：SIA、芯八哥整理

从区域来看，日本是唯一实现增长的地区，而中国大陆同比跌幅达 34.2%，是表现最差的地区。

图表 4：2023 年 2 月全球半导体各区域销售额（亿美元）

地区/国家	1 月	2 月	同比增长（%）
美洲	116.8	99.5	-14.8%
欧洲	45.1	44.7	-0.9%
日本	38.6	39	1.0%
中国	166.7	109.7	-34.2%

地区/国家	1 月	2 月	同比增长（%）
其他地区	133.2	103.9	-22.0%
总计	500.4	396.8	-20.7%

资料来源：SIA、芯八哥整理

（2）半导体指数回调，市场犹疑

从资本市场指数来看，Q1 费城半导体指数上涨 29.18%，中国半导体（SW）行业指数增长 9.26%，受供应链回暖影响，市场信心有所回升。

图表 5：2023Q1 费城及申万半导体指数走势

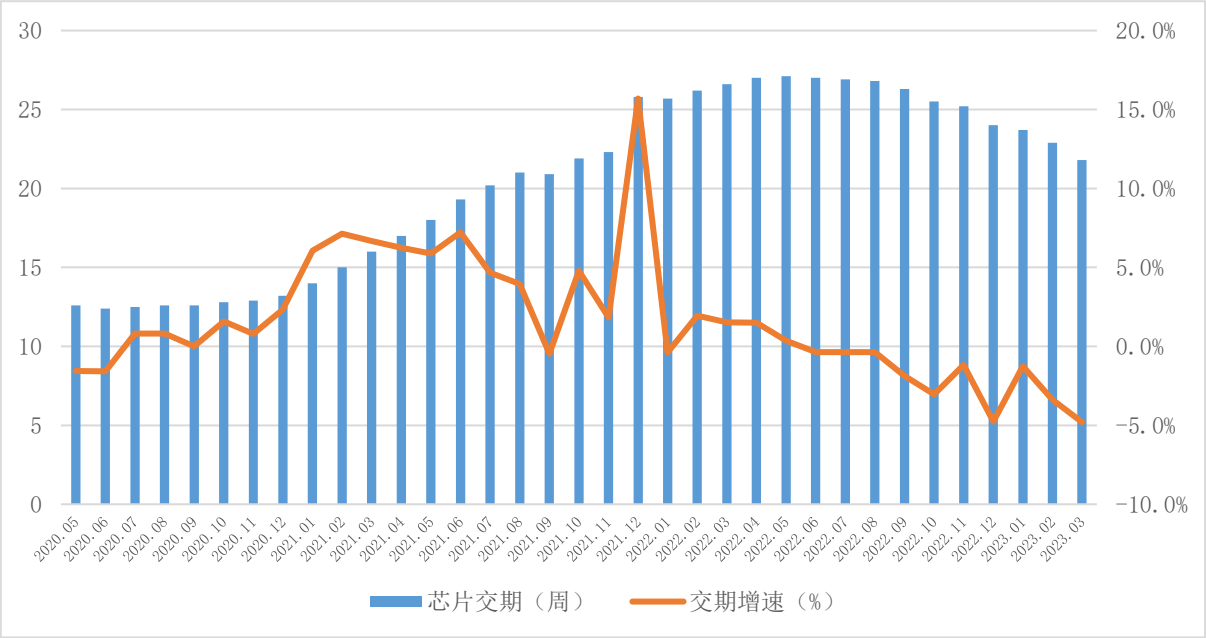
资料来源：Wind 资讯

3、芯片交期趋势

（1）芯片交期趋势

2023Q1，全球芯片交货周期同比减少 8.02%，广泛的供应链问题正明显改善，缺芯危机有望结束。

图表 6：2023Q1 芯片交期趋势



资料来源：Susquehanna Financial Group

（2）供应商交期汇总

从各细分品类货期及价格看，整体货期及价格下调趋势明显，包括 MCU、MOS 等热门品类均有下调趋势，FPGA 交期和价格也趋向于稳定。

图表 7：2023Q1 重点芯片供应商芯片交期一览

类别	产品	厂商	Q1 交期/周	Q2 交期趋势	Q2 价格趋势
MCU	8 位 MCU	ST	35-52	下降	稳定
		Infineon	26-52	稳定	稳定
		Microchip	36-52+	下降	上升
		NXP	35-52	下降	稳定
	32 位 MCU	Renesas	40	下降	上升
		ST	紧缺	上升	上升
		Infineon	26-52	下降	稳定
		NXP	26-52	下降	稳定
		TI	20-45	下降	稳定
FPGA	FPGA	AMD（Xilinx）	20-65	稳定	上升
		Intel（Altera）	30-55	稳定	稳定

类别	产品	厂商	Q1 交期/周	Q2 交期趋势	Q2 价格趋势
		Microchip (Microsemi)	32-52+	下降	稳定
模拟	传感器	AMS OSRAM	8-38	稳定	根据市场调整
		Infineon	18-52	稳定	上升
		NXP	16-52	上升	上升
		ON Semi	18-52	上升	上升
	开关稳压器	Infineon	40-52	稳定	上升
		ADI	20-35	上升	稳定
		ON Semi	35-50	稳定	上升
		ST	40-50	稳定	稳定
	信号链	ADI	20-30	稳定	上升
		Microchip	30-40	稳定	稳定
		ST	28-40	下降	稳定
	多源模拟/电源	ON Semi	35-42	稳定	上升
		ST	40-50	稳定	稳定
存储	eMMC	三星	52-54	稳定	稳定
		SK 海力士	8-12	下降	根据市场调整
	EEPROM	ST	52-54	稳定	稳定
		ON Semi	20-40	稳定	上升
	SRAM	Infineon	12-52	下降	稳定
		Microchip	46-48	稳定	上升
	NAND	SK 海力士	8-12	下降	稳定
分立器件	低压 Mosfet	Infineon	26-54	下降	稳定
		ST	50-54	稳定	稳定
		Diodes	26-54	下降	稳定
	IGBT	Infineon	39-50	稳定	稳定
		ST	47-52	稳定	稳定
被动元件	专用电容	村田	16-18	下降	稳定
		TDK	16-18	下降	稳定

资料来源：富昌电子、芯八哥整理

4、订单及库存情况

从 Q1 热度较高的标杆企业行情看，NXP、ST 及 Infineon 车规料需求持续增长，工控料需求趋缓，消费料未有好转。

图表 8：Q1 市场热点品类及厂商一览

厂商	典型料号	应用领域	备注
TI	MSP、TMS320 等	工控、汽车	订单减少，价格回归常态
ST	STM32F 系列	汽车	车规料看涨
ADI	LTM 系列等	通信	通用料跌幅较大
NXP	车规级 FSx、MCFx 系列等和工业类 MK 系列	汽车、工业	车规/工业料看好， Q2 有望缓解
On Semi	MBRS 系列	汽车	车规料需求增长
Infineon	SAK 系列	汽车	看好 IGBT 需求，工控料下滑
瑞萨	R5Fxx/ISLxx 等系列	汽车	需求相对低迷
Microchip	KSZ8999I、PIC32MX795F512、ATXMEGA128 系列	汽车、消费电子	交期缓解
Lattice	/	通信、数据中心	交期趋稳
高通	AR8031-AL3B、AR8035-AL1A-R 等	消费电子	整体需求疲软
博通	PLX 系列及部分车规料等	汽车、工业	交期较长

资料来源：芯八哥整理

从企业订单及实际库存情况看，消费料订单及价格仍持续下跌，常规料基本需求及价格回归常态，车规/工业料供给和价格趋于稳定。

图表 9：Q1 头部企业订单及库存情况

公司	Q1 订单情况	Q1 库存情况	Q2 定价趋势
Intel	下降	一般	根据市场调整
AMD	下降	一般	稳定
三星	下降	一般	下降
TI	下降	较低	根据市场调整
ST	稳定	低	根据市场调整

公司	Q1 订单情况	Q1 库存情况	Q2 定价趋势
ADI	稳定	低	稳定
高通	下降	一般	根据市场调整
博通	下降	一般	下降
NXP	稳定	低	上升
Infineon	稳定	一般	上升
瑞萨	稳定	一般	根据市场调整
On Semi	稳定	较低	上升
Microchip	稳定	一般	稳定
镁光	下降	一般	下降
联发科	下降	一般	下降

注：高>较高>一般/稳定>较低>低>无

资料来源：芯八哥整理

二、半导体供应链

供应链库存去化顶点已过，行业景气度回转虽缓但稳。

1、半导体上游厂商

（1）硅晶圆/设备

2023Q1，设备和晶圆材料需求进入下行周期。

图表 10：Q1 半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况

类型	企业	Q1 订单	Q1 库存	Q2 订单预测
设备	ASML	稳定	一般	根据市场情况调整
	AMAT	稳定	低	稳定
	泛林	稳定	一般	根据市场情况调整
	TEL	稳定	一般	稳定
	科磊	稳定	低	根据市场情况调整
	北方华创	稳定	低	上升
	中微公司	稳定	低	上升

类型	企业	Q1 订单	Q1 库存	Q2 订单预测
硅晶圆	信越化学	下降	一般	下降
	Sumco(胜高)	下降	一般	下降
	环球晶圆	下降	较高	下降
	台胜科技	下降	较高	下降
	合晶科技	下降	较高	下降
	沪硅产业	稳定	一般	下降

资料来源：芯八哥整理

（2）原厂

2023Q1，原厂订单趋弱，但扩产态势不减。

图表 11：Q1 主要原厂最新动态

类别	厂商	Q1 动态
裁员	Intel	宣布裁员降薪
	高通	以色列开启新一轮裁员
	IBM	客户砍单增加
	镁光	新加坡开始裁员，全球裁员比例提升至 15%
	Marvell	在美裁员 320 人，以应对行业放缓
价格	三星	芯片价格降幅超过预期
	联发科	5G 芯片价格降至 18 美元；部分驱动 IC 调涨 10-15%
扩产	Intel	增加 10 亿美元扩大越南投资
	TI	美国犹他州建造第二座晶圆厂；成都第二座封测试厂或年内投产
	ADI	斥资 10 亿美元升级俄勒冈半导体工厂
	东芝	扩大功率半导体产能
	ST	2023 年计划投资约 40 亿美元扩产晶圆产能
	Infineon	德国 300mm 晶圆厂获批提前启动；2027 年碳化硅产能增加 10 倍
	瑞萨	考虑扩大日本以外地区的芯片产能
	Microchip	投资 8.8 亿美元扩大碳化硅 8 寸晶圆厂；俄勒冈州投资 8 亿美元扩产，MCU 及模拟产品产能将提高三倍
	Rapidus	将在北海道建设半导体工厂
	国巨	预计明年 MLCC 产能提升 10%
	村田	法国卡昂新建一条 200mm 晶圆生产线

类别	厂商	Q1 动态
	太阳诱电	八幡 MLCC 材料钛酸钡新工厂完工
订单	TI	客户砍单增加
	三星	半导体业务 1-2 月已亏损 3 万亿韩元
	On Semi	与宝马汽车签署 SiC 芯片长期供货合同；与大众汽车签署碳化硅技术合作协议
	三星	将为宝马供应 SoC；计划减少采购硅晶圆
并购	西部数据	重启与铠侠的并购交易谈判
	Infineon	已出售 HiRel DC-DC 转换器业务
	博通	收购 VMware 交易期限延长
	On Semi	完成格芯 300mm East Fishkill 纽约工厂和制造工厂收购
	Ouster	和 Velodyne 完成合并
	瑞萨	宣布收购 NFC 公司 Panthronics
	东芝	接受 JIP2 万亿日元收购要约
	豪威	购芯力特，加码汽车半导体业务
国产替代	华为	基本实现了 14nm 以上 EDA 工具国产化
	海思	海思手机芯片市场份额跌至 0%
	兆易创新	车规级 MCU 等产品导入供应链加速

资料来源：芯八哥整理

（3）晶圆代工

2023Q1，下游库存调整刺激下，代工端面临砍单与降价压力。

图表 12：Q1 主要晶圆代工厂最新动态

厂商	Q1 产能利用率	Q1 动态	Q2 价格趋势
台积电	70%-90%	采购取消，订单下调，扩产放缓	下降
三星	85%＜	降价抢单，缩减投资	下降
联电	70%	营收下跌，订单下降，产能下调	下降
中芯国际	70%-80%	增资扩产	下降
格芯	90%＜	决策保守	稳定
世界先进	50%-60%	报价下调，支出下降	下降
力积电	60%-70%	客户违约，产能下调	下降

资料来源：芯八哥整理

（4）封装测试

2023Q1，行业持续低景气度，Chiplet 高端封测是焦点。

图表 13：Q1 主要封测厂商动态情况

厂商	Q1 产能利用率	Q1 动态	Q2 订单预测
日月光	80%＜	营收削减，看好高端封测	下降
长电科技	80%-85	Chiplet 系列工艺实现量产	下降
通富微电	80%-90%	AMD 订单占比超 80%	下降
华天科技	80%＜	Chiplet 工艺已量产	下降
气派科技	80%-90%	2022 年亏损	下降
中小封测厂	40%-60%	低景气度，或迎兼并潮	下降

资料来源：芯八哥整理

2、分销商

业内预期 2023 下半年行业库存去化完成。

图表 14：Q1 主要元器件分销商最新动态

厂商	Q1 动态
艾睿	2022 年亚太地区营收下滑
文晔科技	预计 2023 下半年需求回调
大联大	预估下游库存 Q2 回稳；6.5 亿新台币并购 VSELL 扩大被动元件布局
贸泽电子	与 Xvisio Technology 签订全球分销协议
富昌电子	大多数产品类别货期显著缩短
中电港	成功上市
深圳华强	2022 年扣非净利润 9.61 亿元，同比增长 10.76%
雅创电子	拟收购威雅利 17.12%股份
好上好	境外采购占采购总额比重逐年降低
力源信息	多款自研 MCU 芯片量产

资料来源：芯八哥整理

3、系统集成

2023Q1，工控需求稳定，传统 tier1 加速电气化转型，消费类厂商海外布局提速。

图表 15：Q1 主要系统集成商最新动态

类别	厂商	Q1 动态
工控	ABB	2 月 10 日起调涨价格 3%-10%
	德力西	产品调涨 1%-11%
	施耐德电气	在华第五大研发中心在无锡开幕，聚焦自动化
	汇川技术	2022 年工业机器人销售订单实现 50%以上增长
	罗克韦尔	收购服务和解决方案商 Knowledge Lens
汽车	现代摩比斯	未来三年在移动出行解决方案投资额将超 530 亿人民币
	麦格纳国际	投资近 7 亿美元扩产电动车相关产品业务
	博世集团	新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地在苏州奠基
	华为	2022 年智能汽车业务收入 22 亿元
	法雷奥	辅助驾驶订单暴增，将继续加大在华投资
	采埃孚	计划在德国萨尔州建芯片厂
	博格华纳	5 亿美元投资 Wolfspeed
消费电子	闻泰科技	积极布局新能源领域
	华勤技术	专注于智能硬件，尝试进入汽车电子市场
	立讯精密	中长期目标是成为汽车零部件 Tier 1
	歌尔股份	智能穿戴产品是公司既定战略方向
	鸿海	2023 年将向东南亚扩张
	和硕	计划在印度开设第二座工厂

资料来源：芯八哥整理

4、终端应用

（1）消费电子

2023Q1，消费电子需求仍低迷，但复苏较快。

图表 16：Q1 消费电子厂商最新动态

类别	企业	Q1 动态
智能手机	苹果	1-2 月超过三星成为全球出货量最大的手机厂商
	三星	2022 年智能手机出货量下降 4.1%，今年出货量或低于去年水平
	华为	消费终端业务下行趋势放缓；折叠屏手机中国市场份额第一
	小米	2022 年智能手机毛利率降至 9%；或将获得新能源汽车生产资质
	OPPO	收缩德国和英国业务；自研手机 AP 或年底量产
	联想	拯救者手机放弃，仅保留摩托罗拉业务
	魅族	联手吉利打造“手机+汽车”融合
	荣耀	折叠屏手机在今年下半年较去年有翻倍增长
	Vivo	整合旗下 iQOO，开启降本增效
PC	联想	2022 年 PC 出货量 6900 万台，同比下滑 17.3%
	惠普	惠普委外发包 PC 基频芯片订单洗牌
	华硕	PC 库存已经开始下降
	戴尔	PC 库存有所增加；将裁员约 6650 人
VR/AR	Meta	收购智能镜头商 Luxexcel 强化 AR 业务
	歌尔	推出 XR 业内首个一站式音频解决方案
	苹果	AR / VR 设备量产将延后至 Q3 中后期

资料来源：芯八哥整理

（2）汽车

2023Q1，传统燃油车降价促销，关注汽车行业洗牌期及供应链变动。

图表 17：Q1 汽车厂商最新动态

厂商	Q1 动态
比亚迪	拟越南设汽车零部件厂；新车全系用 NVIDIA Drive Orin 芯片
特斯拉	下一代平台减少 75%碳化硅用量；拟 7.76 亿美元扩建得州超级工厂
现代	与三星电子签订半导体委托设计、代工合约
大众	今年将新建 2.5 万个充电桩；新能源汽车样板基地落户佛山
宝马	2030 年电动车比重达到 50%
奔驰	中国将是未来 10 年增长最快的市场之一，继续扩大在华投资
丰田	对包括电池在内的纯电动汽车规划投资超 4 万亿日元
广汽埃安	2023 年冲击 50 万辆销量目标；与华为合作项目变自主开发
吉利	2023 年新能源销量相比 2022 年翻番

厂商	Q1 动态
奇瑞	官降最高 9000 元
蔚来	规划合肥新建 40GWH 产能电池厂
小鹏	P7i 电控由汇川技术独家供应；2023 年目标交付 45 万辆新车
理想	累计交付车辆超 30 万辆
腾势	3 月 1 日起腾势 D9 上涨 6000 元
小米	汽车完成冬季测试
上汽	拟设立 40 亿元基金，聚焦半导体、新能源领域

资料来源：芯八哥整理

（3）工控

2023Q1，工控市场需求维持稳定增长态势。

图表 18：Q1 工控厂商最新动态

厂商	Q1 动态
施耐德	将在匈牙利投资 160 亿建设新厂
三菱电机	将在日本建造新的半导体工厂
霍尼韦尔	5.05 亿美元出售其电力转换部门；获中国商飞优秀质量奖
信捷电气	公司业务涉及智能制造
英威腾	拟 10.5 亿元投建英威腾苏州产业园三期项目
禾川科技	机器人领域重点客户为拓斯达、新时达、埃夫特等
埃斯顿	工业机器人产品与外资品牌产品整体价差在 15%-30%
汇川技术	广汽、奇瑞等传统车企客户订单开始放量
新时达	公司以运动控制技术为核心
麦格米特	充电桩领域具备整机生产能力

资料来源：芯八哥整理

（4）光伏

2023Q1，持续关注海外市场需求进展。

图表 19：Q1 光伏厂商最新动态

厂商	Q1 动态
阳光电源	全球累计开发、建设光伏/风力发电站超 2500 万千瓦
天合光能	完成可转债募资 88.65 亿元
锦浪科技	订单充足，产能利用率饱满
固德威	产品聚焦欧洲市场为主
英威腾	2022 年公司光伏业务以国内为主，今年前两个月国内和海外占比各一半
华为	2022 年光伏逆变器市场份额达 24.7%
德业股份	年产 68 万套逆变器系列项目延期；公司 IGBT 国产化率约 50%
古瑞瓦特	2022 年公司光伏逆变器出货量为 930520 台；海外工厂落址越南
正泰电器	2023 组件目标出货 30GW，2025 年产能 70GW
特变电工	拟投资 40 亿元建设户用分布式光伏项目

资料来源：芯八哥整理

（5）储能

2023Q1，关注国内工商业储能产业链机会。

图表 20：Q1 储能厂商最新动态

厂商	Q1 动态
阳光电源	2023 年大储出货量预计 15GWh，户用储能逆变器出货量约 70-90 万台
科士达	2023 年储能收入上调至 45-50 亿元
上能电气	储能变流器市场出货量中国第一；正在开拓美国市场
科陆电子	美的收购不确定性增加
中天科技	前两月储能订单超 21 亿元
禾迈股份	储能主要市场在欧洲、亚太地区，美国市场布局中
德业股份	公司在美市场 15KW 及以上产品出货占比约 20%
英威腾	主要聚焦分布式光储逆变器
固德威	小功率储能 PCS 领域出货量获得全球第一
古瑞瓦特	2022 年公司储能系统出货量为 555,764 套

资料来源：芯八哥整理

（6）服务器

2023Q1，服务器市场增速低于预期，不确定风险增加。

图表 21：Q1 服务器厂商最新动态

企业	Q1 动态
宁畅	三大液冷服务器生产基地年产能超过 18 万台
浪潮	牵头发布服务器液冷冷板标准
新华三	新华三剩余股权收购今年内希望能完成
戴尔	仍待解决在 ODM 与仓储的半成品
HPE	调降 ODM 的主板生产
谷歌	计划自研服务器芯片
闻泰科技	服务器产品已正在客户测试中，业务尚处早期

资料来源：芯八哥整理

（7）通信

2023Q1，5G 建设将进入稳定期关注 5G +/6G 技术发展。

图表 22：Q1 通信厂商最新动态

企业	Q1 动态
华为	2022 年 ICT 基础设施业务 3540 亿元
中兴通讯	2022 年中公司 5G 基站、5G 核心网、光传输 200G 端口发货量均全球第二
思科	2022 年全球 SP 路由器和交换机市场排名第一
诺基亚	2022 年全球 5G 专利占 7.6%
爱立信	将在全球分阶段裁员 8500 人
三星	公布标准化 5G NTN 技术

资料来源：芯八哥整理

三、分销与采购机遇及风险

1、机遇

2023Q1，关注消费类市场复苏机会。

图表 23：Q1 细分市场机会关注

产品	发展前景	相关企业
车载摄像头	中国汽车 ADAS 摄像头规模可达 250 亿元	博世、法雷奥及 TTE、德赛西威等
驱动 IC	驱动 IC 下半年市场有望回温	三星、Magna、瑞鼎及集创北方等
算力芯片	ChatGPT 爆红提升算力芯片需求	英伟达、高通、三星及华为等
汽车面板	2023 年汽车面板出货量将超 2 亿块	三星、京东方、天马及集创北方等
智能家居	2026 年智能家居设备规模或超 2790 亿	苹果、三星、华为及小米等
折叠手机	2023 年全球折叠手机出货量或达 1900 万台	三星、华为及京东方、天马等
SiC 功率器件	2023 年 SiC 功率器件将突破 22 亿	ST、安森美、Infineon 及比亚迪半导体等

资料来源：芯八哥整理

2、风险

2023Q1，汽车供应链潜在风险值得关注。

图表 24：Q1 细分市场风险预警

产品	风险预警	相关企业
AR/VR 设备	AR/VR 设备 2022 年出货量下滑 12%	Meta、华为和歌尔股份
存储	三星芯片部门 Q4 利润骤降 90%	三星、SK 海力士和长鑫、长江等
MCU	消费类 MCU 降价去化库存	ST、NXP 及新唐、凌通、松翰、兆易创新等
MLCC	被动件大厂产能下调	太阳诱电、村田及国巨等
手机 OEM	手机 OEM 继续进行库存调整	三星、小米及闻泰、华勤、龙旗等
PMIC、MOSFET、MCU 等	车企芯片供应链或陷入砍单杀价	TI、NXP、ST 等

资料来源：芯八哥整理

四、小结

2023Q1，行业库存去化加速，库存压力缓解，部分终端需求呈现回暖迹象。行业整体处于过渡调整的阵痛阶段，复苏周期或比预期提前，谨慎关注终端需求和头部厂商库存边际变化。

免责声明

本文由芯八哥®内容团队整理，观点仅代表作者本人，芯八哥®对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本刊提醒读者，本报告内容及观点仅供学习参考，不构成任何投资及应用建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

深圳华强电子网集团股份有限公司

2023 年 04 月

华强电子网集团
Huaqiang Electronic Network Group

更高效 更透明 重构产业生态

仓储服务 元器件采购 信息服务 API/FTP
PCB制板 BOM工具 SAAS

www.hqewgroup.com

深圳总部
电话：86-755-83396000
传真：86-755-26421633
地址：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦
B 座 4、7、9、12 楼